

2023年2月20日

中央日本土地建物グループ株式会社が発行するサステナビリティ・リンク・ボンドへの投資について

株式会社テクノ菱和（代表者名：黒田英彦、以下「当社」という）は、このたび、中央日本土地建物グループ株式会社が発行するサステナビリティ・リンク・ボンド（中央日本土地建物グループ株式会社第6回無担保社債、以下「本債券」という）への投資を実施しましたので、お知らせします。

サステナビリティ・リンク・ボンドとは、事前に決められたサステナビリティ/ESG⁽¹⁾ 目標を発行体が達成するか否かにより、経済的及び/又は構造的特性が変容し得る、様々な種類の債券のことでESG投資の対象となります。予め定めた時間軸でサステナビリティ上の成果を改善させることを、発行体が明示的に（債券関係書類における表示を含む）コミットすることとなります。それらの目標は、①事前に決められた重要業績評価指標（KPI）により測定され、②事前に決められたサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）により評価されます。

当社は本債券への投資を通じて、国連の持続可能な開発目標（SDGs）⁽²⁾ のうち、「目標7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」、目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、の達成に貢献します。

<本債券の概要>

銘柄	中央日本土地建物グループ株式会社 第6回無担保社債
年限	5年
発行額	180億円
発行日	2023年2月16日

(1) ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉。「ESG投資」とはこれらの要素を重視・選別して行う投資のこと

(2) 持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年9月の国連持続可能な開発サミットにて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が掲げる、加盟各国が2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットのこと

